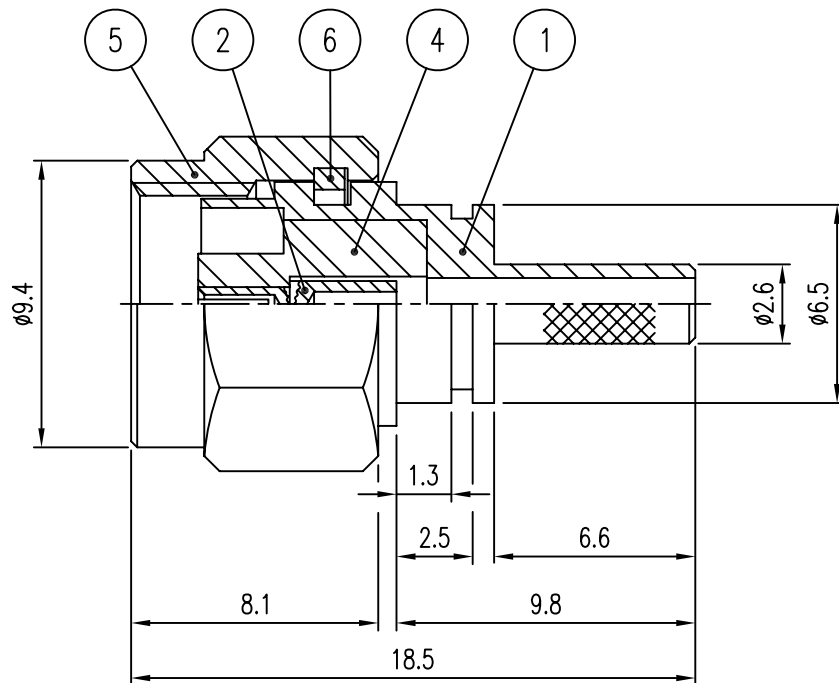


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	[첨변No.202203-0008] HPE 공용화 부품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022.	03.	15.			



6	SPRING RING	1	PWR 2A	Gold Plate	DSR00011-5/1 (R4003)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00040-5/1 (K4003)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00386-N/1 (H4005)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate Gold Plate	DFE00034-5/1 DFE00031-5/1 (K2002)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00438-5/1 9E4003)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00541-5/1 (D4003)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2000. 2. 9.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
	재질	검도			도명	SMZ(SCREW)-PC-179	
열처리	재도						
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번	CN00225-7/1
	적도 4/1	단위 mm	중량	K317-080-000			